

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 17,793,527 股，每股发行价格为人民币 57.83 元。募集资金总额为人民币 1,028,999,666.41 元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币 14,683,392.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,014,316,273.54 元。2020 年 12 月 28 日，募集资金账户实际到账金额为 1,015,709,669.75 元（含募集资金到账时尚未支付的验资费、律师费、信息披露费等 1,393,396.21 元）。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司本年度实际使用募集资金 39,923.21 万元，累计已使用募集资金 39,923.21 万元，募集资金余额为 62,358.36 万元（包括累计收到的银行存款利息扣出银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年1月15日，本公司与存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户（账号：498875522450）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：10551301040055605）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户余额
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	498875522450	21,394.97
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	10551301040055605	41,035.56
合计		62,430.53

注：账户余额62,430.53与募集资金余额62,358.36的差额72.17万元为待支付的发行费用。

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金适用情况

截至2021年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,923.21万元。具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为17,770.81万元。本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为55,000万元。公司使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。

公司 2021 年上半年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：人民币万元

序号	银行名称	产品类型	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收回理财收益
1	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	保本结构性存款	对公结构性存款产品	10,000	2021.06.10	2021.09.08	3.00%	-
2	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	保本结构性存款	对公结构性存款产品	5,000	2021.06.10	2021.08.16	2.90%	-
3	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	保本结构性存款	对公定制人民币结构性存款产品	40,000	2021.05.28	2021.11.24	3.75%	-
4	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	保本结构性存款	对公结构性存款产品	14,000	2021.03.08	2021.06.07	3.00%	157.97
5	中国银行股份有限公司苏州	保本结构性存款	对公结构性存款产品	16,000	2021.03.08	2021.06.08	3.00%	60.49

	工业园区 分行							
6	中国农业 银行股份 有限公司 苏州工业 园区支行	保本结 构性存 款	对公定 制人民 币结构 性存款 产品	40,000	2021.02.25	2021.05.21	3.55%	330.68

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				101,431.63	本年度投入募集资金总额						39,923.21	
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额						39,923.21	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	否	101,431.63	101,431.63	101,431.63	39,923.21	39,923.21	61,508.42	39.36	尚处于建设期	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告三、(三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
其他使用情况					无							